

課題番号 : F-13-FA-0013
利用形態 : 機器利用
利用課題名 (日本語) : 評価用 LED の組み立て
Program Title (English) : Assembly of LED Device
利用者名 (日本語) : 外村 翼, 猿渡 洋孝
Username (English) : T.Tomura, H.Sawatari
所属名 (日本語) : 三菱化学株式会社
Affiliation (English) : Mitsubishi Chemical Corporation

1. 概要 (Summary)

評価用 LED pkg の組み立て

- ・チップのダイボンダーおよびワイヤーボンダー実施
- ・Pkg のダイシング実施



Die & Wire bonder

Dicing Saw

写真のような LED pkg を組み立てることができた。

- ・ワイヤーボンダーは問題なし。
- ・ワイヤーボンダーは Au 線 25um Φ 20um Φ を使用して 1st のボール径および US Power の条件出しを行い良好な 1st ボールが得られた。
- ・pkg のダイシングのブレードの選定, 断面評価を実施し良好な結果が得られた。

4. その他・特記事項 (Others)

なし。

5. 論文・学会発表 (Publication/Presentation)

なし。

2. 実験 (Experimental)

使用した装置

- ・エポキシダイボンダー : WEST・BOND 7200CR
- ・ワイヤーボンダー : WEST・BOND 747677E
- ・ダイシングソー : DISCO DAD322

6. 関連特許 (Patent)

なし。

3. 結果と考察 (Results and Discussion)

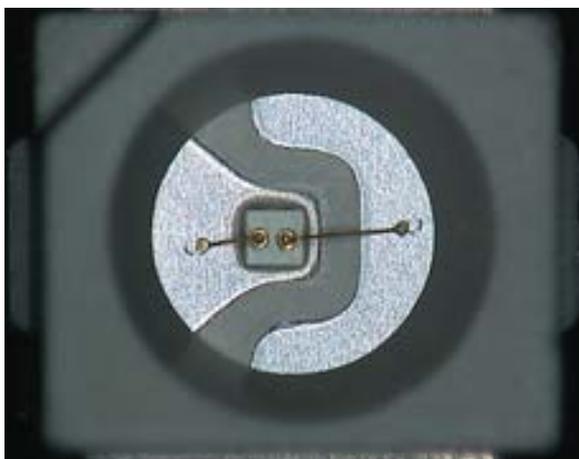


Fig1. Image of LED device